## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-133363

(43) Date of publication of application: 09.08.1983

(51)Int.Cl.

C23C 3/02

C23F 7/00

C25D 5/02

(21)Application number : 57-015400

(71)Applicant: AICHI STEEL WORKS LTD

(22)Date of filing:

01.02.1982

(72)Inventor: KOJIMA KOREHIKO

TAZAKI KUNIO

# (54) PARTIAL PLATING METHOD USING CHEMICAL FORMING FILM AS MASKING (57) Abstract:

PURPOSE: To partially form a metal coating layer on an Al matrix having a complicated shape at a high speed, by a method wherein a metal coating part is formed on the local part of an Al surface by using metal halide and, after a chemical forming film is formed only on the Al surface, electroless plating is applied thereon.

CONSTITUTION: After sticky vaseline is thinly applied to the part of the surface of an Al material, a fine powder of metal halide such as copper halide or tin halide are scattered thereon and, after th whole is heated to a temp. generating substitution reaction between metal halide and Al or more, the residue is removed by washing. By this method, the Al material locally coated with different kind metal is obtained. In the next step, the treated Al material is thrown into a treating liquid prepared by hot pure water or aqueous ammonia to 80° C or more to form a dense protective boehmite coating film. Finally, coated metal is activated according to necessity and the activated Al material is immersed in an electroless plating liquid to apply plating to the Al material and the different kind metal. The plated material is thereafter washed and dried.

### ① 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開.

## ⑩ 公開特許公報 (A)

昭58—133363

**1** Int. Cl.<sup>3</sup>

識別記号

庁内整理番号 7011—4K 砂公開 昭和58年(1983)8月9日

C 23 C 3/02 C 23 F 7/00 C 25 D 5/02

7011—4K 7511—4K 6575—4K

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

**図化成被膜をマスキングとした部分メツキ法** 

願 昭57-15400

②出 願 昭57(1982) 2 月 1 日

⑫発 明 者 小島是彦

②特

愛知県知多郡岡田字袖山32番地

**⑩**発 明 者 田崎国夫

刈谷市半城土中町3丁目6番地

8

①出 願 人 愛知製鋼株式会社

東海市荒尾町ワノ割1番地

明 細 眷

#### 1.発明の名称

化成被膜をマスキッグとした部分メッキ法

#### 2. 特許請求の範囲

ハロゲン化金属塩をアルミニウム要面の局部に接触させ、該金属塩とアルミニウムとの間に置換 反応が生ずる温度以上に加熱して金属被覆部を形成し、該アルミニウムを80℃以上の純水又は水 溶液中に受債して、即配金属被覆部を除くアルミニウム表面に化成被膜を形成した後、無電解メッキを施すことを特徴とする化成被膜をマスキングとした部分メッキ法。

#### 8. 発明の詳細な説明

本発明は、ハロゲン化金属塩をアルミニウム又はその合金(以下単ドアルミニウムという)表面の局部に接触させ、該金属塩とアルミニウムとの間に置換反応が生ずる温度以上に加熱して形成された金属被優部に、便にメッキを施す部分メッキ法の改善に関する。

本発明者等は、上記従来法の欠点を除去するため種々研究を重ねた。その結果、アルミニウム表面に従来、その耐食性向上のために行なわれている化成処理を削記等種金属被運部にマスキングを施さずに、施したところ、該異種金属被運部を考

持開昭58-133363(2)

本発明は、かかる研究の結果に基づくものであって、その要旨とするところは、ハロゲン化金属塩をアルミニウム表面の局部に接触させ、酸金属塩とアルミニウムとの間に置換反応が生ずる温度以上に加熱して金属被優部を形成し、酸アルミニウムを80℃以上の純水又は水溶液中に浸渍氏で、町配金属被優部を除くアルミニウム表面に化成し

法として知られている化成処理を施す。化成処理 液は、被優金異を腐食するものは避けられるべき であり、この条件に合うものとしては、純水又は アンモニアの水溶液が良い。これらの処理液を 80 ℃以上に加熱し、前記アルミニウム材を投入 すると、電気的な方法によらず前記溶液と金属と の間で次式で表わされる反応が生じて、アルミニ ウム表面部に、緻密で保護性のベーマイト被膜が 生ずるのである。

2A1 + 6H = O → A1 = O → nH = O + (8-1) H = O + 8H = 処理時間は、被覆金属の処理液に対する耐食性 と、後工程の無電解メッキにおけるマスキング作 用とに必要な厚さの関係によって決まり、通常は 8 ~ 8 0 分間である。

この化成処理は、簡単な公知の接置を利用して 経済的に施すことができる。この処理で得られる 被膜は、自然に得られる酸化被膜より厚く、これ が次の無電解メッキの場合のマスキングの作用を すると考えられる。又、この被膜は、最終製品に 残存して防食効果を奏するため、通常のマスキン た後、無電解メッキを施すことを特徴とする化成 被膜をマスキングとした部分メッキ法である。

次に、本発明方法を金属被優工程、化成処理工程及び無電解メッキ工程に分けて説明する(第1 図参照)。

先ず、金属被覆工程を削記異種金属被覆方法によって説明する。第1工程において、アルミニウムがの表面の一部に粘着性のあるりセリンを薄において、毎年において、その独立のでは銀等のハロゲン化金属塩の公司を設定した。これによって制度を発音を発音されたアルミニウムが得られる。

この異種金属被模工程は、上配方法だけに限定 、 されるものではなく、同種の被標が得られる他の 方法を包含するものである。

次に、化成処理工程を説明する。前記工程で得られた異種金属被優部を有するアルミニウム材について、一般にアルミニウムに対する防食処理方

グのように除去する必要がなく、手間が省けるものである。

最後に、無道解メッキ工程を説明する。

前記工程で被優された異種金銭が、触媒的性質の比較的弱い貴金属、例えば銅であるときは、表面の触媒活性が足りないため、無電解メッキ反応が及中に浸漬しても、そのままではメッキ反応が改せているとこで、このような場合は、酸に浸漬して活性化する必要がある。しかし、前記工程で被優された異種金銭が触媒的性質の強い金銭であるときは、活性化処理を施す必要がない。

特開昭58-133363(3)

結果、例えば銅冶の上に1人のニッケルメッキ層を得ることができる。このニッケルメッキ層は、密着性が高い。他方、前配化成処埋を施されたアルミニウム表面部は、化成被膜によって無電解メッキ層が生成されることはない。

このように、本発明の部分メッキ方法は、一般にいうマスキングを施すことなく、複雑な形状のアルミニウム母材の凹凸の局部にも、部分的に金閣を迅速に形成することができると共に、生産性の高い量産化が可能なものであり、そのととなり、これを除去する必要がないばかりか、製品表面に残して防食作用をさせることができるものである。

次に、本発明方法をその1 実施例に基づいて説明する。。

先ず、アルミニウム材W(第2図(A)参照)の表面の一部にワセリンをむらなく博く塗布し、その塗布面に塩化第1網の結晶酸粉末を散布密着し、 次いでこの母材Wを炉内に挿入して460℃附近ま

は、ニッケルメッキは点在もしていなかった(第 2 図(D) 参照)。

<b>*</b>			
確譲ニッケル	409/2	次亜リン酸ナトリウム	209/4
クエン酸ナトリウム	24 "	塩化アンモニウム	5
酢酸 "	14 "	PH	5.5 *

なお、化成処理工程を省いたアルミニウム材W に、上配無電解メッキを施した場合は、アルミニウム表面部1にもニッケルメッキ6が形成された。
4. 図面の簡単な説明

図面は、本発明の説明用図にして、第1図は工程図、第2図は実施例の図である。

1:アルミニウム表面部 2:銅被運層

8: 化成処理液 4: 化成被膜

5:無電解メッキ 6:ニッケルメッキ面

W:アルミニワム付

で加熱し、アルミニウムと塩化第1銅との間に遺 換反応を生じさせる。反応完了の発煙終了で加熱 を中止してアルミニウム材Wを取り出して、常温 まで冷却した後、表面の残渣を水洗除去すると、 前配一部表面に銅雕 2 が得られる(第2図(B)参照)。

次に、前記一部に銅被優されたアルミニウム材 勝 Wの1枚を沸騰したイオン交換水 8 中に 1 0 分間 受債し、他の1枚を沸騰した 8 多 アンモニア水溶 被 8 中で 5 分間浸漬してアルミニウム 表面 1 にそ れぞれ虹成被膜 4 を形成した(第 2 図(C) 参照)。

最後に、肢アルミニウム材Wは、10多硫酸溶液中に2~8秒間浸漬して取り出し、水洗した。この結果、核アルミニウム表面部1は、化放成 供給 4が残存し、銅被優部2は、腐食されず、解解的性質を有していた。この前処理が施されたアルミニクム材Wは、次表に示される60℃の無能してカリンキ液5に5分間浸渍して取り出して、アルメッキ6が施された製品を得にこの場合、化成処理されたアルミニウム表面の場合、化成処理されたアルミニウム表面の場合、化成処理されたアルミニウム表面の場合、化成処理されたアルミニウム表面の場合、

